

中信证券股份有限公司
关于
北京世维通科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
上市保荐书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二六年六月

目 录

目 录.....	1
声 明.....	2
第一节 本次证券发行基本情况.....	3
一、发行人基本情况.....	3
二、本次发行情况.....	14
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况.....	14
四、保荐人与发行人的关联关系.....	15
五、保荐人内部审核程序和内核意见.....	17
第二节 保荐人承诺事项.....	18
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见.....	19
一、保荐意见.....	19
二、本次发行履行了必要的决策程序.....	19
三、发行人符合科创板定位和国家产业政策.....	20
四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件.....	21
五、对公司持续督导期间的工作安排.....	23

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京世维通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

发行人名称：北京世维通科技股份有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院1号楼11层1102-2室

成立日期：2016年9月28日

联系方式：010-61597788

本次证券发行类型：首次公开发行股票并在科创板上市

（二）发行人的主营业务

世维通是一家专注于光电子器件及传感器研发生产的国家级专精特新企业，主要产品包括光电子集成器件及组件、强电磁环境光纤电流传感器。公司成立以来，始终以国家重大战略需求为导向，坚持自主创新，不仅在国防及航天领域中解决了光纤陀螺核心器件被国外禁运及技术“卡脖子”的难题，填补了国内产业化空白，而且在电力特高压光纤电流传感器及核心模组市场里成功打破欧美的技术垄断，实现了国产替代，更是在国家超高功率激光器及全球可控核聚变等战略新兴与未来产业赛道中，贡献了自主可控的“世维通”力量。

世维通主要产品——Y波导调制器，是光纤陀螺实现高精度角速度测量的核心器件，广泛应用于海陆空天军民领域的惯性导航系统。强电磁环境光纤电流传感器是一种基于法拉第磁光效应、具备强抗电磁干扰能力的高精度电流测量装备，主要用于特高压直流输电、可控核聚变装置及大型铝电解槽等极端强电磁场景下的电流精准测量。

（三）发行人的核心技术及研发水平

截至本上市保荐书签署日，公司掌握的主要核心技术情况如下：

序号	核心技术名称	对应产品	核心技术内容	技术来源	对应专利	所处阶段	核心技术的先进性、具体表征及应用情况
1	高环境适应性保护技术	Y波导	Y波导芯片表面的电极对相当于平板电容的两个电极，其间的介质会引起电容变化，导致弛豫现象，影响Y波导的电光调制特性。在电极对涂绝缘保护胶，隔绝外界水汽影响，保持电光调制特性不受外界环境影响。	自主研发	无	批量生产	由世维通公司在国内首先提出并批量应用于产品，并且世维通公司提出的电光调制特性指标一波形斜度，已成为行业标准。
2	高偏振消光比Y波导芯片制作	Y波导	针对高精度光纤陀螺，偏振相关噪声指标要求Y波导的芯片消光比要达到80dB。通过研究Y波导芯片的起偏机理，在芯片底部和侧面开槽并填充消光物质，可有效降低反射光重新耦合进输出光纤。	自主研发	ZL201720330267.6 Y波导芯片	批量生产	高消光比Y波导的芯片消光比达80dB，已批量成熟应用，相关芯片处理技术也批量应用于常规芯片，提高芯片消光比10dB以上。
3	光纤环与Y波导芯片直接耦合技术	Y波导	光纤经绕环后，偏振保持能力会下降，无法通过监控尾纤偏振串音最小值的方式找准轴向。通过找出串音值与旋转角度曲线两侧等值对应角度值，可计算出最佳对准角度。	自主研发	ZL202020408667.6 快速准确偏振对准装置	批量生产	已批量应用于光纤环与Y波导芯片直接耦合，经截断测试，耦合对准角度优于1°。
4	Y波导低漏气率密封技术	Y波导	针对特殊应用环境，设计开发密封结构Y波导，尾纤偏振串音参数基本不变，高密封性。	自主研发	ZL202221550459.5 气密性封装的铌酸锂光学器件	批量生产	常温尾纤偏振串音要求 $\leq -28\text{dB}$ ，全温 $\leq -23\text{dB}$ ，漏率 $\leq 1 \times 10^{-10}\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，已在产品中批量应用
5	低复位误差Y波导制作技术	Y波导	通过精确控制芯片的加工过程，以及特别的调控方法，充分减少芯片的电极作用区可移动离子的数量，抑制其活跃度，降低直流漂移。	自主研发	无	批量生产	复位误差对称性 $\leq 0.5^\circ/\text{h}$ （2.5ms采样，天向，千分之一精度测试系统），已在产品中批量应用

序号	核心技术名称	对应产品	核心技术内容	技术来源	对应专利	所处阶段	核心技术的先进性、具体表征及应用情况
6	高光损伤阈值波导制备技术	近红外高能电光相位调制器	通过对波导截面形状、折射率分布及电极结构的系统优化，同时将热效应等控制在可接受范围内，实现近红外大光功率持续工作下的结构稳定性与性能一致性。	自主研发	无	批量生产	器件光损伤阈值达到300mw以上，处于国内领先水平，已在产品中批量应用
7	恶劣环境耐受气密封装技术	近红外高能电光相位调制器	采用独特的气密光纤组件设计方案，通过精密设计金属化配件与光纤过渡层级结构，构建了从刚性管壳到柔性光纤的渐进式应力缓冲层，有效化解焊接温度与热应力对保偏光纤的影响，在保证高带宽器件微波性能的前提下，实现了全系列产品的气密封装。	自主研发	ZL201911360917.1 尾纤组件及包括其的电光调制器	批量生产	器件可在宽温度范围、高温高湿、盐雾及霉菌等极端恶劣环境下长期稳定运行，已在产品中批量应用
8	自动化耦合技术	超辐射光发射组件	利用栅格扫描法获得该X-Y平面内SLD场强的分布，其作为输入的变量，根据神经网络得出的调整矢量，信号处理与控制模块控制高精度位移平台移动到耦合功率的最大位置。	自主研发	无	批量生产	采用爬山算法每走一步都会有启发信息进行引导，确定下一步前进的方向以及前进的距离，比较各个方向与当前节点的高度差，找到最优解，已在产品中批量应用
9	SLD波长稳定性技术	超辐射光发射组件	通过精确控制氮化铝基板的尺寸和结构，充分减少外界环境对芯片的影响，通过温控系统，实现芯片周围稳定的环境。	自主研发	无	批量生产	器件波长稳定性由于业内普遍的200ppm左右降低到100ppm以下，已在产品中批量应用

序号	核心技术名称	对应产品	核心技术内容	技术来源	对应专利	所处阶段	核心技术的先进性、具体表征及应用情况
10	恶劣环境耐受气密封装技术	PIN-FET 光接收组件	PIN-FET 组件产品的元件与电路板、电路板与管壳采用焊料工艺焊接，替代了传统的胶工艺，从工艺上控制了管壳腔体的水汽含量。创新的将回流焊工艺引入到光接收组件产品制作流程，设定好回流焊的温度和时间，可实现自动焊接。焊接过程中同步充氮气，确保焊料不被氧化，使得 PIN-FET 组件内部水汽含量可控制在 5000ppm 以内，降低了管壳腔体的水汽含量，大幅提升了产品的可靠性和一致性。	自主研发	ZL202320882317.7 一种光接收组件的管壳封装结构	批量生产	器件适合车载、军工、野外、高低温、强振动等恶劣场景，已在产品中批量应用
11	宽温范围（-55℃~85℃）电压响应度稳定性技术	PIN-FET 光接收组件	电路设计方面采用场效应管组成共源放大电路，具有输入电阻高，具有噪声低、温度稳定性好的优点；PNP 三极管组成的共基放大电路，是 FET 放大电路的负载，FET 管电容对输入回路的影响减小，具有较好的高频特性；NPN 三极管组成射极跟随器，具有工作稳定、频响宽、输入电阻大和输出电阻小等优点，电路设计时增加温度补偿，在宽温范围内满足线性度高的要求。 （-55℃~85℃）电压响应度优于 3%，提高了陀螺的精度。	自主研发	无	批量生产	为光纤陀螺实现更高测量精度提供了可靠保障，已在产品中批量应用

序号	核心技术名称	对应产品	核心技术内容	技术来源	对应专利	所处阶段	核心技术的先进性、具体表征及应用情况
12	超低高温暗电流技术	InGaAs 光电探测器	通过材料及生长工艺设计、优化器件能带结构与工艺窗口，显著降低了材料缺陷密度及热激发载流子的本征产生率。与此同时，引入优化的低应力钝化层结构和工艺与环孔隔离结构设计，有效抑制了表面漏电流传输通道。	自主研发	无	批量生产	在-5V 反向偏压条件下，常温暗电流典型值可低至 0.01nA 量级，达到行业引领水平。在高温暗电流控制方面，探测器在高温条件下仍具备优异的暗电流稳定性，从而克服了传统器件因高温暗电流劣化导致系统探测灵敏度受限的技术瓶颈。已经在产品中批量应用。
13	高线性度与低失真传输技术	InGaAs 光电探测器	通过材料设计制备、扩散结深及浓度梯度的精确调控，显著优化了器件的二阶与三阶非线性响应特性。通过优化 TO 结构倾角设计，在管帽与芯片之间构建反射抑制，从技术角度抑制反射光进入光纤，降低噪声影响。公司产品二阶互调失真（CSO）指标优于-78dBc，三阶互调失真（CTB）指标优于-85dBc，	自主研发	ZL201720782665.1 低回波损耗的探测器结构	批量生产	两项关键性能参数均大幅超越行业普遍遵循的-70dBc 与-75dBc 标准规范，达到国际同类高端产品先进水准。此特性有效抑制了多信道间的交叉串扰，为多频道复合信号的图像清晰度提供了核心物理保障。已经在产品中批量应用。

序号	核心技术名称	对应产品	核心技术内容	技术来源	对应专利	所处阶段	核心技术的先进性、具体表征及应用情况
14	应用于光纤通信及光纤传感领域的小型化技术及高稳定高响应技术	InGaAs 光电探测器	通过结构、工艺及可靠性设计，完整集成高性能探测器芯片及光学透镜在直径 1.8mm 的密封结构内，设计兼顾机械强度及长期气密性，有效抑制微型腔体内的杂散光反射及热噪声串扰。采用多维度固定方式，使内部光电敏感单元在外部宽频机械激励下保持相位稳定，结合微应力释放设计，有效稳定外部振动能量向内部光敏区域的传递，抑制动态形变对耦合效率的影响。	自主研发	ZL202020354739.3 探测器 ZL201821317235.3 光学连接组件	批量生产	满足了光纤通信及光纤传感领域对组件微型化、集成化的演进趋势，具备优异的长期可靠性与极低的失效率。并作为关键功能单元被客户广泛应用于光通信系统的光放大器中。满足高可靠性需求，在振动过程中，响应度变化量不超过 5%。一般产品只能满足振动前后响应度变化量不超过 10%，已在产品中批量应用
15	光纤电流传感器系统控制、信号处理与宽频特性技术	强电磁环境光纤电流传感器	涵盖光路调制、信号解调、闭环控制、信号获取与处理算法，以及宽频（工频~高频）响应特性	自主研发	ZL202311764352.X 光纤电流传感器、控制方法及装置	批量生产	全数字多闭环相位差分检测系统，整机核心控制，柔性直流/新能源并网高频暂态测量
16	误差预防与非线性补偿技术	强电磁环境光纤电流传感器	误差前置预防机制、非线性误差建模与动态补偿	自主研发	ZL202410115059.9 光纤电流传感器的非线性误差建模方法、介质及电子设备	批量生产	抑制温度/振动误差，适应兆安级大动态范围测量
17	分布式与波分复用多路传感技术	强电磁环境光纤电流传感器	多节点组网、波分复用/时分复用同步测量	自主研发	ZL202410808990.5 一种分布式光纤传感阵列、测量系统及方法 ZL201811543085.2 基于波分复用的多路光纤电流传感器及其控制方法、系统	批量生产	电解槽电流分布、换流站多支路同步监测

序号	核心技术名称	对应产品	核心技术内容	技术来源	对应专利	所处阶段	核心技术的先进性、具体表征及应用情况
18	电解铝阳极分布电流测量技术	强电磁环境光纤电流传感器	基于单光纤环的电解槽多阳极电流分布式在线测量	自主研发	ZL202310687248.9 一种测量铝电解槽区域阳极电流的系统及方法、电子设备 ZL202310948786.9 基于单光纤环的区域阳极电流测量系统及电解槽测量系统	批量生产	电解铝行业阳极电流分布在线监测，工艺优化与节能降耗
19	光纤传感器抗振动、抗静磁场等设计技术	强电磁环境光纤电流传感器	传感头抗振动、抗温变、抗静磁场等环境适应性结构设计	自主研发	ZL202311667115.1 一种圆偏振光纤起偏器及包括其的光纤传感系统 ZL202211409970.8 一种光纤电流互感器	批量生产	提升复杂电磁/振动/温度环境下测量稳定性，全系列传感器头部件
20	手持与集成化光纤电流测量技术	强电磁环境光纤电流传感器	便携式非接触测量 + 光电器件一体化集成	自主研发	ZL202111536160.4 一种光纤电流传感器 ZL202311649099.3 一种光纤电流检测装置	批量生产	冶金行业“即夹即测”，销往国际铝业巨头；多场景灵活部署
21	关键器件测试与整机校验技术	强电磁环境光纤电流传感器	Y波导参数测量、SLD光源测试、电子式互感器校验	自主研发	ZL202010201236.7 一种Y波导参数测量仪、测量系统及测量方法 ZL201710104147.9 SLD光源测试系统	批量生产	芯片产线测试、出厂校验与第三方计量溯源

(四) 发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标

主要财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
流动比率（倍）	6.17	12.26	10.09
速动比率（倍）	5.19	10.23	8.17
资产负债率（合并）	13.97%	7.86%	10.72%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	12.63	11.47	9.91
利息保障倍数（倍）	483.22	198.20	143.04
应收账款周转率（次）	2.77	2.36	2.69
存货周转率（次）	1.01	0.95	0.93
息税折旧摊销前利润（万元）	14,740.37	12,428.24	14,194.82
归属于发行人股东的净利润（万元）	10,832.49	9,037.20	10,686.27
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	10,315.04	8,665.40	10,362.62
研发投入占营业收入的比例	8.87%	10.92%	8.93%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.30	1.64	1.91
每股净现金流量（元/股）	0.53	-1.70	1.22

注：上述财务指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产；
- 4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的期末净资产/期末普通股份总数；
- 5、利息保障倍数=息税前利润/利息费用；
- 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 7、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- 8、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销；
- 9、研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入；
- 10、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
- 11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加/(减少)额/期末股本总额

(五) 发行人的主要风险**1、与发行人相关的风险****(1) 产品研发失败以及技术升级风险**

光电子器件是信息获取、传输和交互的关键器件，其技术水平和产品性能直接影响信息系统的整体效能。为顺应市场需求变化并应对日趋激烈的行业竞争，公司需持续投入大量资金与人力资源，以推进现有产品的技术升级及新产品的研发工作。光波导调制器属于典型的技术密集型产业，核心技术能力是企业维持市场竞争优势的根本保障。若公司在新产品、新技术的研发创新方面无法满足市场

对产品迭代的实际需求，未能跟上行业技术升级的步伐，或在持续创新能力及紧跟下游客户发展趋势方面有所滞后，则可能面临市场份额被逐步侵蚀的风险，对公司的市场地位造成不利影响。此外，公司技术成果的产业化与市场化进程具有一定的不确定性，若在研发、产品测试或试生产等关键环节出现核心技术未能突破、研发项目失败或产品性能未达预期等情况，公司将难以收回前期投入的研发成本、无法实现预期效益，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

(2) 客户需求波动的风险

公司核心产品 Y 波导调制器等集成光电子器件主要应用于国防军工、航空航天等领域。上述领域客户的采购需求受国防预算、装备采购周期及国家宏观政策等因素影响较大，存在一定的不确定性。若未来国防预算增速放缓、相关装备采购计划调整或主要客户采购需求减少，可能导致公司订单波动，对经营业绩产生不利影响。

(3) 舆情相关风险

随着公司业务不断拓展以及产品市场影响力的持续提升，各类媒体对公司的关注度与报道频率也随之增加。目前，公司已建立并持续完善舆情监控机制，对相关媒体报道进行常态化跟踪与管理。然而，若未来出现涉及公司的重大负面或失实报道，而公司未能及时发现并作出澄清，则可能对公司的正常经营与发展造成不利影响。

(4) 毛利率下滑风险

报告期内，公司营业收入综合毛利率分别为 59.54%、56.87%和 58.75%，处于较高水平。若未来出现市场竞争加剧、下游客户要求降价、上游原材料价格上涨、公司未能持续保持技术领先优势、新产品迭代不及预期等情形，公司可能面临毛利率下降的风险，进而对经营业绩产生不利影响。

(5) 公司客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例分别为 69.86%、70.17%及 65.91%，客户集中度相对较高。若公司未来新客户拓展、新业务领域开拓不达预期，或主要客户因国内外宏观环境或者自身经营状况发生变化导致对公司产品的需求量发生重大不利变化，亦或合作关系被其他供应商所取

代等，将对公司未来经营业绩产生不利影响。

(6) 应收票据及应收账款余额较高导致的坏账风险

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 7,290.06 万元、5,065.41 万元和 10,754.31 万元，应收账款账面价值分别为 10,922.85 万元、12,620.24 万元和 9,745.59 万元，合计占同期营业收入的比例分别为 61.55%、59.63%和 61.62%。应收账款与应收票据占用了公司一定规模的营运资金，公司存在因应收账款及应收票据回款不及时甚至无法收回导致公司产生坏账损失的风险。

(7) 存货规模较大及跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 13,104.60 万元、12,915.21 万元和 13,457.00 万元，占总资产的比例分别为 16.97%、14.74%和 12.99%。随着公司业务规模的增长，公司存货账面价值整体呈现小幅上升趋势。若未来下游客户需求发生变化或行业竞争态势出现重大调整，公司产品可能无法实现预期销售，进而导致存货跌价准备计提增加的风险。

(8) 租赁相关风险

公司目前经营所使用的房产系通过租赁取得。在未来的生产经营中，公司可能因租赁房产到期而导致搬迁并产生额外的费用支出，可能对公司正常生产经营产生不利影响。

(9) 募投项目产能消化的风险

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务和未来发展战略，项目可行性分析是基于对当前市场环境、下游市场需求以及未来技术发展方向等因素作出的。若募集资金到位后，未来宏观经济环境、客户需求以及技术发展趋势等发生重大变化，公司的销售规模不能快速提升，导致募投项目产能消化不及预期，将对公司未来的经营状况带来不利影响。

(10) 经营规模扩大引致的经营管理风险

在本次发行后，随着募集资金的到位和募投项目的建成，公司的生产、销售、研发等规模将逐步扩大，业务规模和管理范围的扩张将会提高公司的经营管理难度，对公司管理层的经营管理能力提出了更高的要求。如果在发展过程中，公司

内部的管理架构和管理模式不能适应未来快速成长的需要,将对公司生产经营造成不利影响。

(11) 未来市场增长风险

公司积极布局强电磁环境光纤电流传感器等战略新兴产品,产品已应用于可控核聚变、特高压输电、冶金工业等领域。上述领域的商业化进程受技术成熟度、下游投资节奏、行业准入政策等因素影响,存在一定不确定性。若核聚变等前沿领域的工程化进度慢于预期,或电力、冶金等民用市场的规模化渗透速度不及公司预期,可能导致相关产品的收入增长放缓,对公司未来业绩增长带来负面影响。

(12) 税收优惠风险

报告期内,公司及子公司享受高新技术企业所得税和先进制造业企业增值税加计抵减的税收优惠;子公司光智能享受软件产品增值税即征即退的优惠。若未来公司或子公司无法继续取得高新技术企业资质、不再符合先进制造业企业增值税加计抵减税收优惠条件,或者相关优惠政策发生变化,则可能导致公司或子公司无法继续享受相关税收优惠政策,将对公司的经营业绩产生不利影响。

2、与行业相关的风险

(1) 宏观环境变化的风险

公司的强电磁环境光纤电流传感器产品主要应用于电力、冶金、可控核聚变等领域。上述产品的市场需求与宏观经济景气度高度相关,若未来宏观经济出现波动,导致下游领域的投资或采购规模缩减,将对公司业务发展产生不利影响。

(2) 市场竞争加剧的风险

公司客户主要为大型国有企业,下游客户对供应商的产品品质、交付周期及供应链稳定性要求不断提高,行业竞争预计将持续加剧,若公司无法在技术研发、经营规模、产品类型及资金实力等方面实现持续巩固与提升,未能敏锐洞察并适应产业的变革趋势与市场需求,将可能导致公司核心竞争优势被削弱、产品定价能力下降,进而对公司的整体经营业绩造成不利影响。

(3) 技术人才流失和核心技术泄密风险

公司所处行业具有显著的研发驱动特征,技术人才储备与核心技术积累构成

了公司持续创新的根本基础。公司始终将核心技术保护置于战略高度，已与所有核心技术人员签订了保密协议，然而依然存在核心技术人员流失、因操作疏忽或外部非法窃取等因素导致核心技术外泄的风险，若发生相关情形，将对公司的生产经营造成不利影响。

3、其他风险

除上述风险因素外，投资者在评价公司本次发行的股票时，还应认真考虑发行失败风险、募投项目实施效果未达预期的风险、即期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险、股票价格可能发生较大波动的风险、安全生产、环境保护、不可抗力等风险。

二、本次发行情况

发行股票种类：	人民币普通股（A）股
发行股数，股东公开发售股数：	本次拟发行股份不超过 2,324.4445 万股（含 2,324.4445 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准），公司股东不公开发售股份
发行方式：	本次发行将采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的发行方式或者中国证监会等监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。本次申请首次公开发行股票可以选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%
每股面值：	人民币 1.00 元
拟上市的交易所和板块：	上海证券交易所科创板
发行后总股本：	不超过 9,297.7780 万股
保荐人（主承销商）：	中信证券股份有限公司

三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定李锐、吴曦为北京世维通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定黄楚然为项目协办人，指定麦健明、郭伟健、何灏天、洪卉中为项目组成员。

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

李锐，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，曾负责或参与了新广益、新莱福、因赛集团、荣之联、海量数据等 IPO 项目；跨境通、英飞拓等非公开发行股票项目；明家联合收购金源互动、跨境通收购环球易购、中

南文化收购极光科技、新莱福收购金南科技等重大资产重组项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。

吴曦，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，曾负责或参与了新莱福、新广益、白云电器、万孚生物等IPO项目；振华科技、瀚蓝环境等非公开发行项目、岭南园林公开发行可转换公司债券项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。

(二) 项目协办人

黄楚然，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾参与雪祺电气IPO、誉帆科技IPO、华盾防务IPO、五新隧装重大资产重组、海奥斯生物新三板挂牌等项目。

(三) 项目组其他成员情况

项目组其他成员包括：麦健明、郭伟健、何灏天、洪卉中。

(四) 本次证券发行上市的项目人员联系方式

本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

联系电话：010-60834526

四、保荐人与发行人的关联关系

(一) 保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人中信证券股份有限公司之全资子公司中信金石投资有限公司担任执行事务合伙人的金石交通、国控金石分别直接持有发行

人 800,000 股、800,000 股，占发行人总股本的 1.15%和 1.15%。

保荐人将根据科创板规则实施跟投，由保荐人或符合规定之关联公司或主体参与本次发行的跟投，后续将按上交所相关规定进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

除前述情况外，截至本上市保荐书签署日，保荐人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员拥有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况，也不存在在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方处任职的情况。

（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）内核程序

中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。本保荐人内部审核具体程序如下：

首先，由内核部按照项目所处阶段及项目组的预约对项目进行现场审核。内核部在受理申请文件之后，由两名专职审核人员分别从法律和财务的角度对项目申请文件进行初审，同时内核部还外聘律师及会计师分别从各自的专业角度对项目申请文件进行审核。审核人员将依据初审情况和外聘律师及会计师的意见向项目组出具审核反馈意见。

其次，内核部将根据项目进度召集和主持内核会议审议项目发行申报申请，审核人员将把项目审核过程中发现的主要问题形成书面报告在内核会上报告给参会委员；同时保荐代表人和项目组需要对问题及其解决措施或落实情况向委员进行解释和说明。在对主要问题进行充分讨论的基础上，由内核委员投票表决决定项目发行申报申请是否通过内核委员会的审核。内核会后，内核部将向项目组出具综合内核会各位委员的意见形成的内核会反馈意见，并由项目组进行答复和落实。

最后，内核部还将对持续督导期间项目组报送的相关文件进行审核，并关注发行人在持续督导期间出现的重大异常情况。

（二）内部核查意见

2026年5月19日，中信证券通过线下形式召开了世维通IPO项目内核会，对该项目申请进行了讨论，经全体参会内核委员投票表决，该项目通过了中信证券内核委员会的审议，同意将北京世维通科技股份有限公司的申请文件上报监管机构审核。

第二节 保荐人承诺事项

一、保荐人已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本保荐人同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

二、保荐人对发行人申请文件、证券发行募集文件中有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容，已结合尽职调查过程中获得的信息对其进行审慎核查，并对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断。保荐人所作的判断与证券服务机构的专业意见不存在重大差异的。

三、保荐人有充分理由确信发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序。

四、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、保荐人保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定以及行业规范。

七、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，并接受上海证券交易所的自律监管。

八、若因保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见

一、保荐意见

本保荐人根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14号）等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人具备《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，本保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、本次发行履行了必要的决策程序

（一）董事会决策程序

2026年4月30日，发行人召开了第四届董事会第四次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案。

（二）股东会决策程序

2026年5月16日，发行人召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案。

综上，本保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

三、发行人符合科创板定位和国家产业政策

（一）公司符合科创板定位要求的具体情况及依据

公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等有关规定对行业领域及对科创属性相关指标的要求，主要包括：

1、公司符合行业领域要求

世维通是一家专注于光电子器件及产品研发生产的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业门类下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“1.2 电子核心产业/1.2.1 新型电子元器件及设备制造”中的“3983 敏感元件及传感器制造”及“3976 光电子器件制造”。因此，发行人所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条（一）中所规定的“新一代信息技术领域-电子信息”。

2、公司符合科创属性要求

公司符合科创属性评价标准的具体情况，详见招股说明书“第二节/五/（三）公司符合科创属性相关指标要求”。

3、公司符合国家经济发展战略和产业政策的具体情况

根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司所从事的“光电子器件”、“敏感元器件及传感器”的研发与制造被列入鼓励类产业，属于“信息产业”门类下的“新型电子元器件制造”领域。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》，公司所属行业领域属于“1.2 电子核心产业/1.2.1 新型电子元器件及设备制造”中的“3983 敏感元件及传感器制造”及“3976 光电子器件制造”。该分类是国家重点发展的战略性新兴产业之一。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司业务属于“新一代信息技术领域”领域中的“电子信息”。

综上，公司主营业务符合国家经济发展战略和产业政策。

（二）保荐人核查过程及意见

保荐人访谈了公司的主要管理人员，了解公司业务经营情况及技术情况；审阅了公司员工花名册及员工简历，了解公司研发人员情况；获取了公司主要采购及销售合同，了解公司客户及供应商情况，对公司主要客户与供应商进行了现场走访及视频访谈，了解交易背景及交易情况，同时履行了对主要客户、供应商进行函证的核查程序；获取了研发费用明细表，查阅了公司研发费用的归集政策，抽查了部分研发费用的会计凭证；收集并审阅了行业研究报告及竞争对手公开披露信息，了解行业信息和竞争对手业务定位。

经核查，保荐人认为世维通归属于新一代信息技术产业，面向国家需求，符合国家战略，符合保荐人优先推荐科创板上市的要求。世维通拥有关键核心技术，科技创新能力突出，自成立以来得到了市场的广泛认可，且具备保持持续研发创新的能力。公司主要依靠核心技术开展生产经营，且经营情况良好。世维通符合科创板定位要求和国家产业政策。

四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件

本保荐人依据《科创板股票上市规则》相关规定，对发行人是否符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

（一）发行人符合证监会规定的发行条件

1、发行人已依据《公司法》等法律法规设立了股东会和董事会，在董事会下设置了审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了独立董事工作制度、董事会秘书工作制度，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度，董事和高级管理人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见《审计报告》，发行人 2023 年度、2024 年度和 2025 年度实现的营业收入金额分别为人民币

29,591.23 万元、29,660.78 万元和 33,268.06 万元；发行人 2023 年度、2024 年度和 2025 年度实现归属于母公司股东净利润分别为 10,686.27 万元、9,037.20 万元和 10,832.49 万元，2023 年度、2024 年度和 2025 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 10,362.62 万元、8,665.40 万元和 10,315.04 万元。发行人财务状况良好，营业收入和净利润表现出了较好的成长性，具有持续盈利能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、容诚会计师审计了发行人最近三年期财务会计报告，并出具了无保留意见的审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据发行人控股股东济南汇中新实业有限公司、实际控制人陈松及发行人各自出具的书面确认、网络核查结果及相关主管机关出具的证明文件，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

发行人本次发行前股本总额为 6,973.3335 万元，本次拟公开发行不超过 2,324.4445 万股，发行后股份总额不超过 9,297.7780 万元，发行后公司的股本总额不低于 3,000 万元，符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上

发行人本次发行前股本总额为 6,973.3335 万元，本次拟公开发行不超过 2,324.4445 万股，公开发行的股份不低于发行后股份总数的 25%，符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

（四）市值及财务指标

1、市值指标

根据《关于发行人预计市值的分析报告》，发行人预计市值符合科创板第一套标准所规定的预计市值不低于人民币 10 亿元的上市市值条件。

2、财务指标

根据容诚会计师出具的《审计报告》，2025 年公司实现营业收入 33,268.06 万元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 10,315.04 万元。

3、标准适用判定

发行人结合自身状况，选择适用《科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）款规定的上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

公司 2024 年和 2025 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 8,665.40 万元和 10,315.04 万元，2025 年的营业收入为 33,268.06 万元。保荐人经谨慎、合理参考最近一年老股转让对应的公司估值、可比公司法及所属板块首发估值情况，最终测算得出发行人的预计市值不低于人民币 10 亿元。综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

五、对公司持续督导期间的工作安排

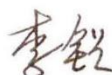
事项	工作安排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会和上海证券交易所相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐及承销协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定

事项	工作安排
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、上海证券交易所报告；按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
（四）其他安排	无

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京世维通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

保荐代表人:



李 锐



吴 曦

项目协办人:



黄楚然



(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京世维通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

内核负责人:




邱志千



(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京世维通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

保荐业务负责人:



孙毅



(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京世维通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

董事长、法定代表人:


张佑君



中信证券股份有限公司

2026 年 6 月 24 日